

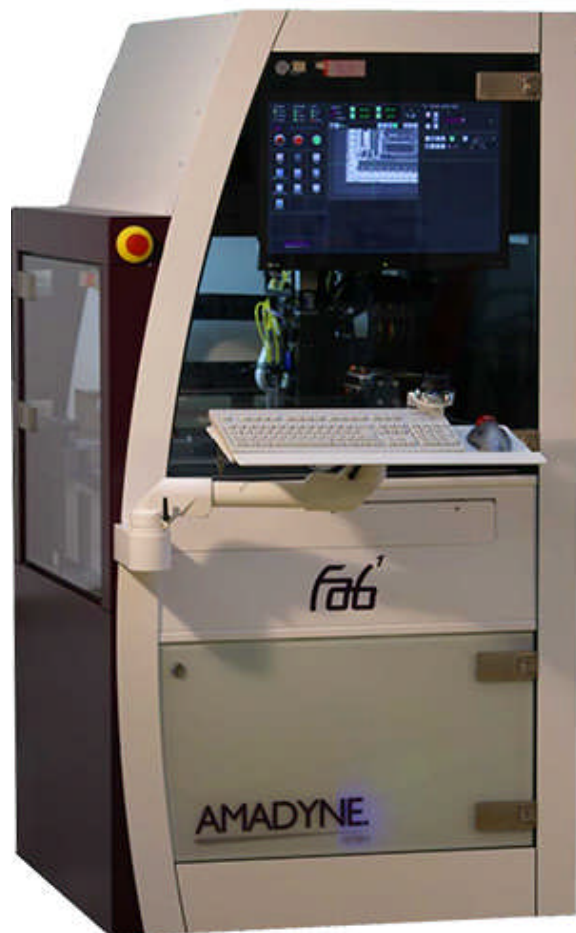
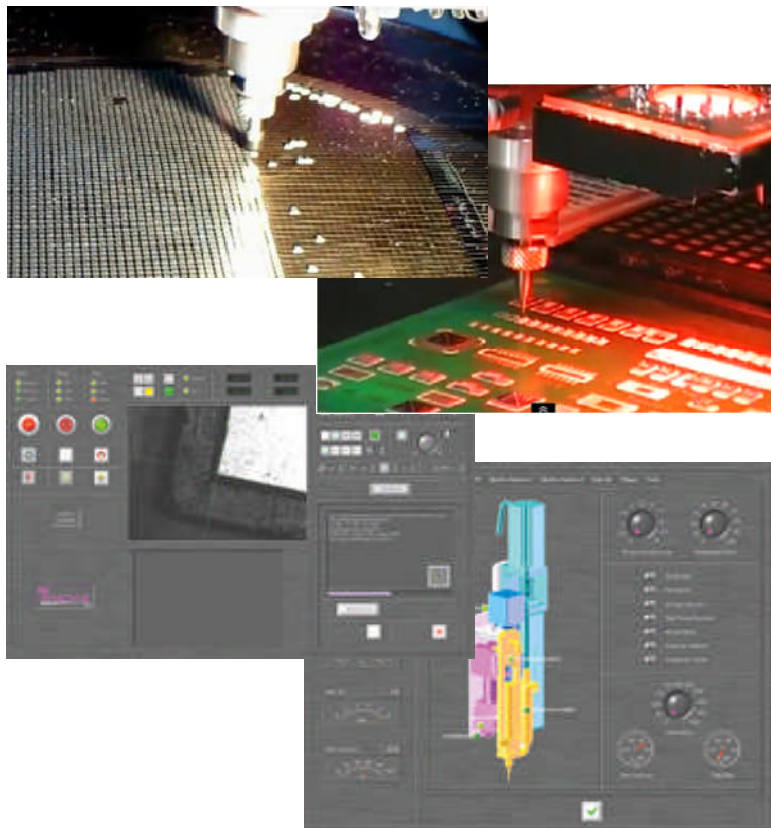
多品種生産ニーズに適した多目的ダイボンダー Fab

ユニバーサル・ダイボンダー

FabFab¹

AMADYNE.

GMBH



複数の実装部品や半導体チップによって構成されるマルチチップモジュール(MCM)等の多品種生産に適した多目的ダイボンダー

ワッフルパック、ゲルパック、テープフィーダー、ウェハー等あらゆる部品供給形態に対応
ダイボンディング、ダイソーティング、および外観検査等、幅広いニーズに利用可能

特長

- X-Yリニアモーター駆動による高速高精度位置決め、4軸制御ピック&プレースヘッド
- X500 x Y430mmのワイド・アセンブリエリア
- 振動低減機能を有する堅牢フレーム構造
- 作業エリアを清浄に保つHEPAフィルター内蔵フローボックス標準装備
- 自動学習機能、簡単操作を提供する対話型ソフトウェア
- ICチップの回路パターンをカメラで自動認識、チップ位置補正および高精度ピック&プレース
- 最大15種類のボンディングツールを自動交換(オプション)

詳細は、株式会社 シンアペックス 電子機器プロジェクト部門までお問合せ下さい。